股票简称:华东数控　　股票代码:002248　　公告编号:2013-008

威海华东数控股份有限公司非公开发行A股股票预案

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD)

(山东省威海市经济技术开发区环山路698号)

二〇一三年三月一日

公司声明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本次非公开发行A股完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股引致的投资风险,由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问,应咨询自己的A股股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、本次非公开发行A股相关事项已经2013年2月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过,尚需取得本公司股东大会审议通过,以及中国证监会等有关部门的批准或核准。

2、本次非公开发行A股的发行对象为高金科技,高金科技将以现金认购本次发行的股份。截至本预案签署之日,高金科技及其控制的其他控股子公司均未持有本公司股份。本次发行完成后,高金科技将持有本公司占发行后股本16.26%的股份。

3、本次非公开发行A股股票的数量为5,000万股。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。

本次非公开发行的A股股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即6.40元/股。

若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,则本次发行的股票数量及发行价格也将作相应调整。

本预案实施后,公司股权分布结构仍符合上市条件。

4、本次非公开发行前,实际控制人合计持有本公司28.26%的股份,机构投资者高新投资持有本公司21.22%的股份;本次非公开发行后,实际控制人持有本公司股份比例摊薄至23.67%,机构投资者高新投资持有本公司股份比例摊薄至17.77%,高金科技持有本公司股份比例16.26%;本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化。

5、高金科技认购的本次非公开发行的股票自本次发行的股份完成股份登记之日起三十六个月内不得转让。

6、由于本次发行后高金科技持有本公司16.26%股权,对本公司经营具有重大影响,为体现双方的长期战略联盟关系,并解决本次发行后产生的潜在同业竞争,高金科技进一步承诺:自本次发行完成之日起三十六个月内,高金科技拟将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司(以下简称"朱米重组")。

就上述标的资产,双方初步达成意向为高金科技的下属公司数控股份的机床制造业务相关股权/资产;数控股份成立于2002年,注定代表人为陈永开,注册资本为人民币10亿元,注册地为大连高新技术产业园区XD港辽河东路100号,数控股份及其控制的企业的主营业务为普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等机床产品的研发、生产与销售。根据未经审计财务数据,数控股份2012年1-9月实现销售收入25.54亿元,净利润2.27亿元。具体涉及未来重组的标的资产以届时双方共同确定的范围及形式为准,因此未来重组的标的资产财务数据可能会与上述公布的数据有所差异。未来重组完成后,对本公司的潜在影响包括:实际控制人将可能发生变更,公司综合竞争力和行业地位将得到提升,公司财务状况将得到改善、抗风险能力将进一步得到提升等。关于未来重组的内容详见"第五章　本次非公开发行A股对公司的影响"。

高金科技将以现金认购本次非公开发行的股份,本次非公开发行不涉及对重组范围内资产的收购;本公司在本次非公开发行完成前将不会启动未来重组相关事项,也不会在本次非公开发行预案披露之日起六个月内启动未来重组相关事项。

未来重组的具体方式、资产评估相关事项、定价、交割等由高金科技与本公司另行签署协议约定,该协议届时需经本公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准后生效。此外,本公司实际控制人同意并承诺,在未重组中,无条件的配合高金科技及本公司的交易行为,并在有关董事会、股东大会议案审议中就未来重组的安排作出同意表决(该等议案的内容须在有关法律、法规规定的情形除外)。

特别提示:

1)未来重组的资产范围目前尚未确定,未来重组的资产范围与本预案中披露的双方所达成的初步意向可能会有差异,未来重组的形式和重组具体方式也尚未确定;

2)未来重组按目前法律流程尚需取得未来重组所涉及资产的相关债权人的同意(如涉及);也尚需双方公司董事会、股东大会/股东会审议批准,且相关方需回避表决,届时能否通过有关审议程序,尚存在不确定性;

3)未来重组的标的资产需经有证券从业资格的会计师事务所审计及资产评估机构评估,届时能否取得该等机构的相应意见,尚存在不确定性;

4)未来重组的有关事宜需经相关方的保荐机构/财务顾问、法律顾问核查并出具专项意见,届时能否取得该等机构的相应意见,尚存在不确定性;

5)未来重组的标的资产的未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合届时的相关法律、法规对重组标的资产的要求,尚存在不确定性;

6)未来重组的标的资产的历史沿革、资产权属情况是否符合届时的相关法律、法规对重组标的资产的要求,尚存在不确定性;

7)未来重组按目前审核流程尚需中国证监会核准,届时能否通过核准,尚存在不确定性;

8)未来重组需以届时有效的相关法律、法规规定的内容为准,如本次发行后有关法律、法规发生变化,则未来重组的程序和方式,以及涉及资产的有关情况是否符合变更后的法律、法规规定,存在不确定性;

9)本次发行完成后的任何政策形势、经济形势、行业趋势、经营策略、市场环境、自然灾害等因素的变化均可能对未来重组造成重大不利影响。

释　义

在本次非公开发行A股之预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

公司、本公司、股份公司、发行人、华东数控	指	威海华东数控股份有限公司
一致行动人、控股股东、实际控制人	指	发行人股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金作为"一致行动人"为发行人控股股东、实际控制人
高新投资	指	发行人股东山东省高新技术创业投资有限公司
高金科技	指	大连高金科技发展有限公司
数控股份	指	大连机床(数控)股份有限公司,高金科技直接和间接合计持有其75.15%的股权
机床集团	指	大连机床集团有限责任公司,持有数控股份44.71%的股权
本次非公开发行A股/本次非公开发行/本次发行	指	威海华东数控股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向高金科技发行5,000万股A股股票之行为
本发行预案	指	威海华东数控股份有限公司本次非公开发行A股股票预案
《公司章程》	指	威海华东数控股份有限公司章程
未来重组	指	目本次发行完成之日起三十六个月内,高金科技拟将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一章　本次非公开发行A股方案概要

一、发行人基本情况

发行人名称:威海华东数控股份有限公司

英文名称:WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD

注册地址:威海经济技术开发区环山路698号

办公地址:威海经济技术开发区环山路698号

法定代表人:汤世贤

成立时间:2002年3月4日

上市时间:2008年6月12日

股票简称:华东数控

股票代码:002248

股票上市地:深圳证券交易所

经营范围:数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售,量具、量仪的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务(需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。

二、本次非公开发行A股的背景和目的

公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展,公司大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟,加工设备基本完备,产品逐渐形成系列化,质量日益稳定,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。公司正在完成以生产中小型机床为主向以生产大型、重型、超重型精密数控机床为的业务转型,以单一生产机床整机产品为主向同时生产机床整机产品和承揽国内外重点工程项目大型、重型、精密部件加工业务并举的经营模式转变。

然而2011年末以来,随着国家宏观经济增速放缓以及主要下游行业固定资产投资的萎缩,公司生产经营开始逐渐面临严峻的挑战:

首先,2012年起受宏观经济形势影响,汽车、船舶、铁路系统、石化等主要下游行业的固定资产投资萎缩明显,机床工具行业增速亦开始大幅下滑,根据中国机床工具工业协会统计,2012年1~11月机床工具行业生产企业切机床73.4万台,比同期降低15.7%,生产数控金切机床18.7万台,比同期降低17.9%,1~11月份机床工具大行业金切机床中的数控机床产量占金切机床产量的25.5%,同比降低0.7个百分点;预示着我国机床工具行业连续近十年的高速增长状态,已经开始逐步转向低速、稳定增长的发展趋势。

其次,公司主要生产的大型、重型、精密机床与普通机床不同,该等产品属于大型机器设备,设备单价高,生产流程较普通机床产品更为复杂,且一般以单个订单定制生产的方式进行;该等大型、重型、精密机床的生产过程所耗原材料价值较高,生产周期较长,产品从完工入库至销售确认亦需经过安装调试、客户再验收等较长的销售周期,公司日常生产经营所需流动资金占用较高。而在下游行业需求下滑明显的大背景下,公司数控大型机床销售下滑明显,行业竞争加剧的同时由于部分下游客户订单违约或延期导致公司库存增加,流动资金占用较为严重;近年来公司大幅增加对外借款以支持日常经营运作,负债结构及偿债能力逐渐恶化,为公司带来较大的财务压力。

为此,公司本次拟通过非公开发行股票的方式向高金科技等集资金,一方面,将募集资金用于偿还部分银行贷款,短期内有助于公司改善财务结构,节约财务费用,提升盈利能力,在行业寒冬中积蓄能量以应对行业复苏后的竞争及机遇;另一方面,通过本次战略入股本公司,高金科技承诺自本次发行完成之日起三十六个月内,拟将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司,双方初步达成意向为高金科技的下属公司数控股份的机床制造业务相关股权/资产,主要包括普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等机床产品的研发、生产与销售。在本次非公开发行完成之日起三十六个月内,拟将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给本公司。就上述标的资产,双方初步达成意向为高金科技的下属公司数控股份的机床制造业务相关股权/资产,主要包括普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等机床产品的研发、生产与销售。本次涉及未来重组的标的资产,以届时双方共同确定的范围及形式为准。未来重组的具体方式、资产评估相关事项、定价、交割等由双方另行签署协议约定,该协议届时需经本公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准后生效。

第四章　关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司拟非公开发行A股5,000万股,发行价格为6.40元/股,拟募集资金总额不超过32,000万元。扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行贷款:

公司具体拟以募集资金偿还的银行贷款如下(以下均为公司本部贷款):　　单位:万元

借款银行	贷款金额	到期日期	年利率	拟以募集资金偿还金额
工商银行	2,800	2013/03/01	6.60%	2,800
建设银行	2,200	2013/12/26	6.30%	2,200
交通银行	4,000	2013/03/24	6.05%	4,000
农业银行	2,000	2013/02/25	7.20%	2,000
农业银行	5,000	2013/05/20	7.20%	5,000
农业银行	2,700	2013/11/12	7.50%	2,700
浦发银行	3,000	2013/05/30	6.90%	3,000
中国银行	3,000	2013/11/19	6.60%	3,000
中国银行	3,000	2013/11/23	6.60%	3,000
中信银行	5,000	2013/03/16	7.20%	4,300
合计	32,700	——	——	32,000

在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对拟偿还单项或多项贷款的金额进行调减。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致,本公司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。

二、使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的必要性及可行性

公司经过近几年的扩张,目前在生产规模、技术水平、产品结构等方面已具备一定的竞争实力,随着高技术含量、高附加值产品的推广,公司的盈利能力和效益将进一步提高,但公司目前的财务结构不利于公司的持续健康发展。

1、与同行业上市公司相比,公司偿债能力较弱

①短期偿债能力与同行业相比较弱

上市公司	流动比率			速动比率			现金比率		
	2010	2011	2012 Q3	2010	2011	2012 Q3	2010	2011	2012 Q3
日发数码	4.75	4.37	4.82	4.11	3.27	3.10	0.35	3.31	2.49
华中数控	1.76	4.28	4.52	1.13	3.37	3.24	0.69	0.62	2.66
亚威股份	0.98	3.63	3.68	0.41	2.34	2.34	0.44	0.21	1.95
青海华鼎	1.91	1.77	1.67	1.00	0.91	0.82	0.56	0.44	0.38
秦川发展	1.59	1.55	1.59	0.90	0.67	0.65	0.58	0.53	0.34
沈阳机床	1.00	0.93	0.93	0.35	0.39	0.40	0.10	0.06	0.11
昆明机床	1.92	1.62	1.65	0.86	0.57	0.47	0.39	0.38	0.19
法因数控	2.16	1.88	2.01	1.32	1.11	1.13	1.63	0.93	0.50
南通科技	1.49	1.39	1.24	0.60	0.47	0.33	0.06	0.51	0.38
华东数控	1.63	0.86	0.80	0.77	0.34	0.29	0.39	0.28	0.09
平均	1.92	2.23	2.29	1.15	1.34	1.28	0.52	0.73	0.91

数据来源:Wind资讯

注:流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款)/流动负债

现金比率=货币资金/流动负债

2011年以来,由于公司数控大型机床技术改造等资本性支出以及配套运营资金的持续增长,公司加大了流动资金贷款规模,流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力下降明显,目前均远低于行业水平;2012年来随着下游客户订单需求增长的放缓以及部分客户订单延期等原因,公司存货占用流动资金的比率逐渐提高,应收账款周转率亦有所下降,导致速动比率及现金比率也下降明显。截至2012年三季度末,公司速动比率及现金比率分别为0.29及0.09,短期来看,公司偿债能力较弱,财务风险较高。

②资本结构与同行业相比财务杠杆更高

上市公司	资产负债率			总债务资本比			净债务资本比		
	2010	2011	2012 Q3	2010	2011	2012 Q3	2010	2011	2012 Q3
日发数码	19.1%	20.3%	17.9%	5.3%	2.8%	4.1%	-68.4%	-58.4%	-36.2%
华中数控	49.3%	22.0%	24.6%	19.3%	5.7%	8.1%	-26.6%	-60.9%	-48.1%
亚威股份	65.3%	23.4%	20.3%	39.8%	2.1%	2.1%	17.4%	-50.0%	-41.1%
青海华鼎	49.6%	59.0%	61.7%	25.1%	36.3%	42.6%	1.2%	12.9%	25.7%
秦川发展	44.3%	43.5%	45.5%	16.9%	20.9%	28.1%	-16.5%	1.2%	14.1%
沈阳机床	85.2%	86.8%	87.3%	74.0%	75.1%	79.5%	66.3%	58.5%	72.2%
昆明机床	36.3%	43.1%	43.7%	3.1%	6.4%	6.7%	-16.9%	-5.9%	-0.1%
法因数控	33.0%	30.4%	29.5%	3.9%	0.0%	0.0%	-31.9%	-18.0%	-18.4%
南通科技	68.3%	67.8%	71.6%	35.2%	43.3%	48.4%	-20.9%	7.6%	19.1%
华东数控	45.1%	58.8%	57.3%	34.8%	45.5%	44.2%	27.0%	40.8%	39.4%
平均	49.6%	45.5%	45.9%	25.7%	23.8%	26.4%	-6.9%	-7.2%	2.6%

数据来源:Wind资讯

注:资产负债率=总负债/总资产

总债务资本比=(短期借款+长期借款)/(短期借款+长期借款+所有者权益)

净债务资本比=总债务资本比-货币资金/(短期借款+长期借款+所有者权益)

基于公司近年来投入大量资金进行技改项目、研发投入及产业链扩张,为保证公司的正常经营,公司不断增加银行贷款。截至2012年三季度末,公司借款金额合计约10.2亿元人民币,其中短期借款6.5亿元,长期借款3.7亿元。公司2011年以来资产负债率、债务资本比持续上升,远高于同行业平均水平,与同行业可比公司相比财务风险较高。

③债务规模与经营规模比例与同行业相比较高

上市公司	总债务/销售收入		
	2010	2011	2012 Q3
日发数码	15.1%	4.9%	11.2%
华中数控	17.4%	13.2%	32.8%
亚威股份	24.6%	2.9%	4.3%
青海华鼎	25.3%	41.5%	72.3%
秦川发展	15.1%	19.1%	49.0%
沈阳机床	54.9%	51.2%	111.7%
昆明机床	2.9%	5.5%	12.1%
法因数控	7.1%	0.0%	0.0%
南通科技	49.1%	73.9%	240.4%
华东数控	89.7%	155.3%	321.9%
平均	30.1%	36.8%	85.6%

数据来源:Wind资讯

注:总债务 = 短期借款+长期借款

近年来,公司债务规模占年销售收入比例逐渐增加,一方面是由于公司各项目投入新增了银行贷款规模,另一方面是由于近年来机床行业需求下滑明显导致公司收入水平下滑。截至2012年三季度末,公司总债务/销售收入比例已经达到321.9%,远高于同行业水平,现阶段的经营规模难以支持公司较高的债务规模。

2、银行信贷成本逐渐提升,对公司利润造成较大负面影响

2012年以来,受宏观经济增幅放缓的影响下游固定资产投资增速逐步放缓,使得公司下游订单需求增速受到较大负面影响,间接影响到公司的偿债能力以及资金周转能力;目前,公司获得银行贷款的利率较基准利率上浮平均15~20%,融资成本显著提升,财务费用的大幅增加使得公司利润受到较大负面影响。2012年前三季度公司累计亏损约3,600万元,其中仅财务费用对利润影响就达到约4,876万元。

3、偿还银行贷款有助于提升公司盈利水平,改善财务状况

根据前述分析,公司目前财务杠杆较高,偿债能力下降明显,且高额债务产生的财务费用对盈利影响较为显著。如以本次募集资金约3.2亿元全部用于偿还公司短期债务,以2012年三季度末财务数据模拟计算,公司流动比率、速动比率将分别升至1.09及0.40,资产负债率、总债务资本比、净债务资本比分别下降至46.7%、35.2%及29.6%,有助于大幅改善公司财务状况。

此外,公司拟偿还贷款每年产生的利息支出合计将近2,200万元,如以本次募集资金约3.2亿元用于偿还上述贷款,则每年可节省利息支出合计约2,200万元,增加公司利润总额2,200万元。

综上所述,公司本次募集资金偿还银行贷款具有可行性。

第五章　本次非公开发行A股对公司的影响

一、本次发行后公司业务及资产整合计划

根据高金科技向本公司出具的承诺:自本次发行完成之日起三十六个月内,高金科技拟将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。

就上述机床制造业务相关股权/资产,双方初步达成意向为高金科技的下属公司数控股份的机床制造业务相关股权/资产,主要包括普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等的研发、生产与销售。具体涉及未来重组的标的资产,以届时双方共同确定的范围及形式为准。

1、数控股份的基本情况

数控股份成立于2002年,法定代表人为陈永开,注册资本为人民币10亿元,注册地为大连高新技术产业园区XD港辽河东路100号,数控股份及其控制的企业的主营业务为普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等机床产品的研发、生产与销售。截至目前,数控股份的股权控制关系图如下:

根据数控股份提供的未经审计的管理层数据,数控股份在2012年前三季度、2011年、2010年的合并财务数据如下表:　　单位:亿元

项　目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
净资产	26.41	24.14	19.36
项　目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
营业收入	25.54	39.98	34.46
净利润	2.27	4.78	4.66
扣除非经常性损益后的净利润	2.22	3.47	3.22

由于其体涉及未来重组的标的资产,以届时双方共同确定的范围及形式为准;因此未来重组的标的资产财务数据可能会与上述公布的数据有所差异。

2、数控股份主要下属子公司的基本情况

①大连华根机械有限公司,成立日期:2001年9月,注册资本:71,686万元,法定代表人:陈永龙,注册地址:大连经济技术开发区XD港辽河东路100号。经营范围:经营本公司生产所需技术、设备、原辅材料的进口及其自产品的出口业务;机床零部件、汽车零部件、机床安装维修;汽车货运;机床设计及咨询服务、进出口业务;承办中外合资经营、合作生产业务、承办来料加工;来样加工、来件装配业务;开展补偿贸易业务(在许可范围内)。

大连华根机械有限公司是数控股份的全资子公司。

②大连大连凯机床有限公司,成立日期:2004年4月,注册资本:2,600万元,法定代表人:陈永龙,注册地址:大连高新产业园区XD港辽河东路100号。经营范围:加工中心及加工中心各种单元的开发、生产、销售及售后服务(设计许可经营的,凭许可证经营)

大连华凯机床有限公司是数控股份的全资子公司。

③大连大力电脑机床有限公司,成立日期:1993年4月,注册资本:4,176万元,法定代表人:马俊庆,注册地址:大连市甘井子区丰收路286号。经营范围:设计、制造、销售电脑数控机床。

大连大力电脑机床有限公司是数控股份的全资子公司。

④大连华根精密机床有限公司,成立日期:2006年6月,注册资本:1,500万元,法定代表人:李长福,注册地址:瓦房店市祝丰街北段600号。经营范围:精密金属切削机床技术开发及产品销售(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

大连华根精密机床有限公司是数控股份的全资子公司。

⑤沈阳中美钻镗机床有限公司,成立日期:2007年1月,注册资本:6,000万元,法定代表人:蔡清刚,注册地址:沈阳市浑南新区大文溯街17-111号。经营范围:普通、数控机床、附件及零部件;三轴以上联动的数控机床,数控系统及交流伺服装置的研发、制造和销售。

沈阳中美钻镗机床有限公司是数控股份的控股子公司。

3、未来重组事项对本公司的潜在影响

①可能导致本公司实际控制人发生变更

本次非公开发行完成后,高金科技将持有本公司16.26%的股权。未来高金科技如将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式出售给本公司,将有可能导致本公司实际控制人发生变更。

②提升公司综合竞争力和行业地位

公司的主要产品是磨削类机床产品。高金科技下属数控股份的机床产品主要包括车削机床、立卧加工中心及专用机床生产线等,重组完成后拓宽了本公司产品线,并且在营销网络、市场客户、售后服务和产品研发等方面给与极大程度的扩充和增强,综合竞争力将获得较大程度的提升。

③改善公司财务状况,提升抗风险能力

未来重组完成后,公司总资产、净资产规模将增加,收入水平及盈利水平较目前将有大幅度的提升,公司融资能力将有效得以提升,资本运作空间亦将增加,财务状况将得到改善,也将进一步提升公司综合抗风险能力。

4、其他需要关注的情况

高金科技将以现金认购本次非公开发行的股份,本次非公开发行不涉及对重组范围内资产的收购;本公司在本次非公开发行完成前将不会启动未来重组相关事项,也不会在本次非公开发行预案披露之日起六个月内启动未来重组相关事项。

未来重组的具体方式、资产评估相关事项、定价、交割等由高金科技与本公司另行签署协议约定,该协议届时需经本公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准后生效。

此外,本公司实际控制人同意并承诺,在未来重组中,无条件的配合高金科技及本公司的交易行为,并在有关董事会、股东大会议案审议中就未来重组的安排作出同意表决(该等议案的内容违反有关法律、法规规定的情形除外)。

特别提示:

1)未来重组的资产范围目前尚未确定,未来重组的资产范围与本预案中披露的双方所达成的初步意向可能会有差异,未来重组的形式和重组具体方式也尚未确定;

2)未来重组按目前法律流程尚需取得未来重组所涉及资产的相关债权人的同意(如涉及);也尚需双方公司董事会、股东大会/股东会审议批准,且相关方需回避表决,届时能否通过有关审议程序,尚存在不确定性;

3)未来重组的标的资产需经有证券从业资格的会计师事务所审计及资产评估机构评估,届时能否取得该等机构的相应意见,尚存在不确定性;

4)未来重组的有关事宜需经相关方的保荐机构/财务顾问、法律顾问核查并出具专项意见,届时能否取得该等机构的相应意见,尚存在不确定性;

5)未来重组的标的资产的未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合届时的相关法律、法规对重组标的资产的要求,尚存在不确定性;

6)未来重组的标的资产的历史沿革、资产权属情况是否符合届时的相关法律、法规对重组标的资产的要求,尚存在不确定性;

7)未来重组按目前审核流程尚需中国证监会核准,届时能否通过核准,尚存在不确定性;

8)未来重组需以届时有效的相关法律、法规规定的内容为准,如本次发行后有关法律、法规发生变化,则未来重组的程序和方式,以及涉及资产的有关情况是否符合变更后的法律、法规规定,存在不确定性;

9)本次发行完成后的任何政策形势、经济形势、行业趋势、经营策略、市场环境、自然灾害等因素的变化均可能对未来重组造成重大不利影响。

二、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况

1、公司章程的变化情况

本次非公开发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行的结果,对《公司章程》相关条款进行修改。

2、对公司股东结构的影响

本次非公开发行A股后,公司的实际控制人未发生变化,但公司的股东结构将发生较大变化。本次非公开发行A股前后公司股东结构变化的情况如下:

项　目	本次非公开发行A股前		本次非公开发行A股后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
实际控制人合计	72,770,664	28.26%	72,770,664	23.67%
其中:汤世贤	38,659,633	15.01%	38,659,633	12.57%
其中:高鹤鸣	20,158,230	7.83%	20,158,230	6.56%
其中:李壮	7,091,221	2.75%	7,091,221	2.31%
其中:刘传金	6,861,580	2.66%	6,861,580	2.23%
高新投资	54,649,486	21.22%	54,649,486	17.77%
高金科技			50,000,000	16.26%
其它A股股东	130,075,450	50.52%	130,075,450	42.30%
合计	257,495,600	100.00%	307,495,600	100.00%

本预案实施后,公司股权分布结构仍符合上市条件。

3、本次非公开发行A股对高管人员结构的影响

本次非公开发行A股对高管人员结构没有影响。

4、本次非公开发行A股对业务收入结构的影响

本次非公开发行A股不会对公司的业务收入结构产生重大影响。

三、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次非公开发行A股募集资金到位后,公司的净资产将得到增加。本次非公开发行A股对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下:

1、对公司财务状况的影响

本次非公开发行A股完成后,公司的净资产将得到增加,拟募集资金偿还贷款后,公司负债水平将下降,公司的资产负债率将降低,从而提升公司的资本实力,优化公司的财务结构。与此同时,公司流动比率、速动比率等将得到提高,短期偿债能力有效提升,有利于降低公司的财务风险,节约利息费用。

2、对公司盈利能力的影响

本次非公开发行A股募集资金用于归还银行贷款后,公司的利息费用支出将得以减少,本次非公开发行A股将有助于提高公司的整体盈利能力。

3、对公司现金流量的影响

本次非公开发行A股完成后,公司筹资活动现金流入将有所增加,随着公司运用募集资金偿还银行贷款,公司偿债能力将有所改善,公司的筹资能力也将有所提升,有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加。

四、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行A股完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,不存在同业竞争和潜在同业竞争关系,也不会导致新增关联交易。

五、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行A股完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方进行担保的情形。

六、本次非公开发行A股对公司负债结构的影响

本次非公开发行A股募集资金用于偿还贷款后,公司的资产负债率水平能够得到有效降低,从而提高企业的抗风险能力和筹资能力。

公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,本次发行后不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第六章　本次非公开发行A股相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行A股股票时,除本预案提供的其他各项料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。

一、行业与市场风险

1、下游需求变化的风险

机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,本公司下游客户主要集中在发电设备、铁路、汽车、通用机械制造、航天航空、车工、钢铁、冶金等领域;上述下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况。2011年以来,国家宏观经济增长逐渐放缓,固定资产投资亦增速放缓明显,对本公司经营状况产生一定影响。若未来国际国内宏观经济形势及固定资产投资增长情况持续恶化,将对本公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响,从而直接影响本公司经营业绩。

2、产业政策变化风险

机床是装备制造业的工作母机,机床行业为装备制造业提供生产设备,机床行业的发展水平决定了下游行业的加工、制造水平,是一个国家机械化、现代化的重要标志,代表着一个国家的科技水平、创新能力和综合能力。目前机床行业受到国家产业政策的积极推动,国家已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《高档数控机床行业与基础制造装备科技重大专项实施方案》、《装备制造业调整振兴规划》等扶持政策,以重点鼓励机床行业向大型化数控化方向进一步发展。但如果未来经济形势发生重大变化,存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

3、市场竞争风险

目前,我国机床行业市场竞争较为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床和普通机床主要面临国内同行业企业的激烈竞争,竞争主要体现在产销规模和发展速度方面。同时,在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、精、多轴、复合、大型的数控机床产品方面,本公司主要面临国内大型国企以及国外企业的竞争,竞争主要体现在质量水平、价格和服务方面。未来本公司若不能及时适应市场竞争的变化而作出相应调整,生产经营将受到影响。

二、经营风险

1、原材料价格波动的风险

本公司产品成本中占比最大的主要原材料为铸件,受近年来钢材价格波动的影响,报告期内铸件价格波动较大。由于铸件成本占比不同及产品定价能力差异,铸件价格波动对本公司不同类型产品的毛利率影响不同——对数控机床产品影响较小、对普通机床产品影响较大。

尽管公司2008年通过增资方式控股山东省主要铸件生产企业之一——荣成市弘久锻铸有限公司,并进一步控制了主要原材料的部分供应渠道,一定程度上抵御了铸件价格波动给本公司带来的经营风险,但若未来原材料价格波动明显,仍将对公司盈利能力带来负面影响。

2、应收账款发生坏账损失的风险

2010、2011年末及2012年三季度末,公司应收账款期末账面价值分别为21,647万元、24,649万元、23,007万元,应收账款周转率分别为3.33、2.71、1.33,呈逐年下滑趋势。公司应收账款的余额增幅较大主要是由于生产经营规模扩大、销售收入增长等原因。另外,本公司近年积极调整产品结构,重点发展的数控龙门机床等大型、定制的机床系列产品销售收入逐年快速增长,该类产品销售对象多为规模较大、信誉良好的客户或经销商,相应应收账款信用期相对较长;同时上述产品在销售时,一般需按销售额的5%-10%比例预留质量保证金,期限多为12个月左右。

虽然应收账款的增长是公司生产经营规模扩大、产品结构调整等正常业务发展需要,而且公司也建立了相应的内部控制制度,以加强合同管理和销售款项的回收管理,但如果本公司不能及时收回应收款项,将会影响公司的经营业绩。

3、期末存货余额较大的风险

2010、2011年末及2012年三季度末,本公司存货期末账面价值分别为31,582万元、48,328万元以及53,068万元,存货周转率分别为1.54、1.12、0.47。公司存货金额较大,主要原因为:①机床制造行业具有产品生产周期相对较长、产品及部件价值相对较高、存货占用较大的行业特点;②公司近年来采取订单式生产并销售的产品比重不断上升,产品生产交货周期与会计分期往往不同步导致期末产成品金额较高;③公司近年来大型数控龙门机床产品订单较多,该类产品材料价值高、生产周期长、完工入库至销售确认需经安装调试、客户再验收等过程,从而使平均在库及在途时间较长,导致期末在产品和产成品占用逐年增加。

未来若公司不能在产能扩张、营业收入持续增长的同时加强对存货的管理,控制存货周转效率,将会影响本公司的经营业绩。

4、本次发行完成后净资产收益率及每股收益短期内被摊薄的风险

本次发行完成后,将增加净资产规模约3.2亿元,股本规模由2.57亿股扩张至3.07亿股,发行完成后短期内存在净资产收益率及每股收益被摊薄的风险;尽管公司通过以募集资金偿还部分银行贷款后将大幅降低财务费用,但若公司运营资金持续需要补充,并继续增加借款,则不排除短期内净资产收益率及每股收益进一步被摊薄的风险。

三、与本次发行相关的风险

1、审批风险

本次非公开发行